

用途



一般等级

特点

Multilayer 积层

Non-Mag Core 非磁性核心(电介质陶瓷)

系列 | 型

MLG

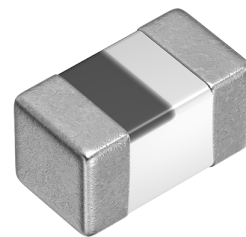
状态



量产体制

品牌

TDK



尺寸

长度(L)	0.60mm ±0.03mm
宽度(W)	0.30mm ±0.03mm
厚度 高低	0.30mm ±0.03mm
推荐焊盘布局(A)	0.25mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.30mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.30mm Nom.

电气特性

电感	2.7nH ±0.2nH at 100MHz
额定电流	300mA
直流电阻 [Typ.]	150mΩ
直流电阻 [Max.]	250mΩ
自我共振频率 [Min.]	6.5GHz
自我共振频率 [Typ.]	8.1GHz
Q [Min.]	4 at 100MHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	15000pcs
重量	0.0002g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

MLG0603S2N7CT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

Associated Images

